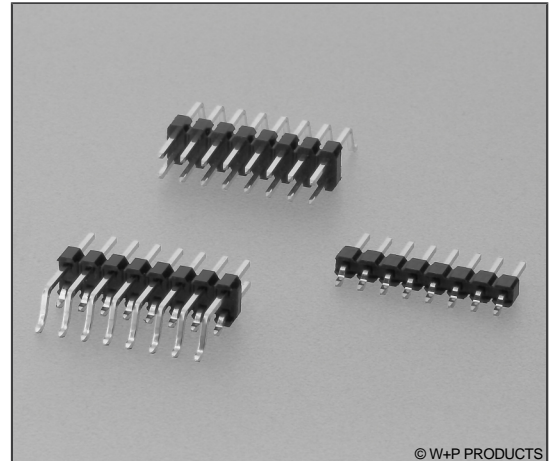


3931 / 3932

SMT-Stiftheilen RM 2,54mm, liegend, 1-/2-reihig SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Horizontal, Single/Double Row

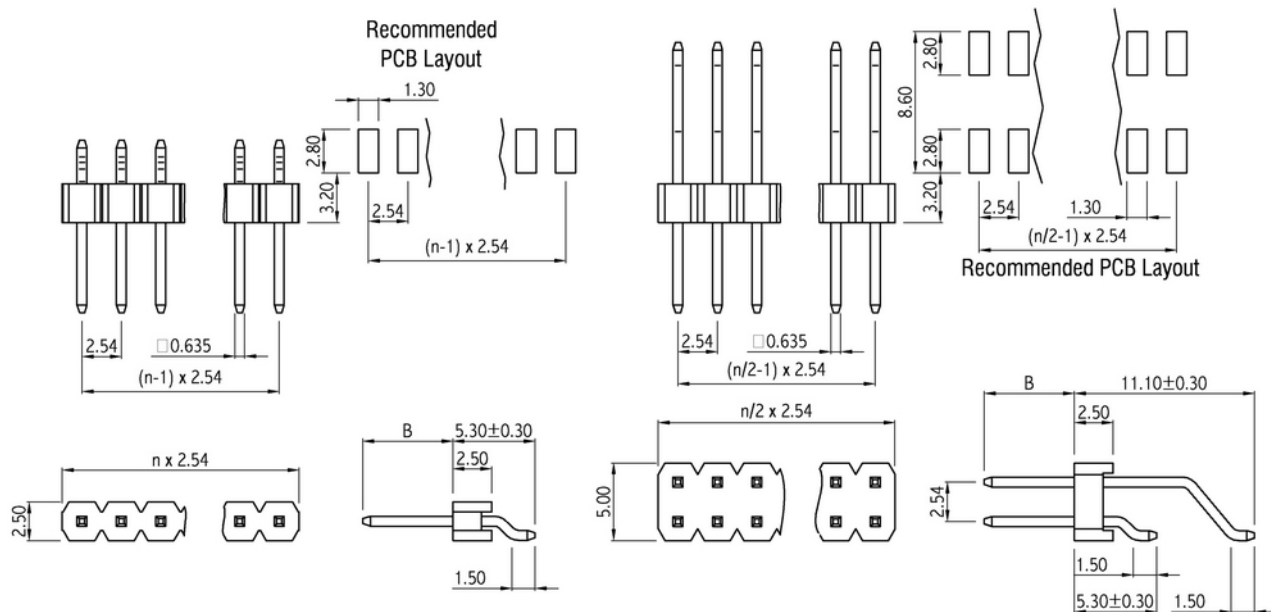
Technische Daten / Technical Data

| | |
|-----------------------|--|
| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung |
| Contact Material | 0.635mm square pin, copper alloy |
| Kontaktfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Contact Surface | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
| Contact Resistance | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000 MΩ |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1 kV DC |
| Test Voltage | 1 kV DC |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Voltage Rating | 250 V AC |
| Nennstrom | 3 A |
| Current Rating | 3 A |
| Temperaturbereich | -55 °C ... +125 °C |
| Temperature Range | -55 °C ... +125 °C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |
| Processing | Reflow soldering |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
3490 3491 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



Series*

3931

Geprägte Kontakte
Stamped/formed contacts
3931 Einreihig
Single row
3932 Zweireihig
Double row

Dimensions*

11

95 B=4,00mm
11 B=5,30mm
12 B=5,80mm
13 B=7,10mm
14 B=8,40mm

Contacts*

008

002-030 Einreihig
Single row
004-060 Zweireihig
Double row

Plating*

50

00 Vergoldet
Gold plated
110 Sel. 0,25µm / Flash Gold
Sel. 0.25µm / flash gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

Packaging*

PPST

ST
PPST
PPTR (Option)

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options on request.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

